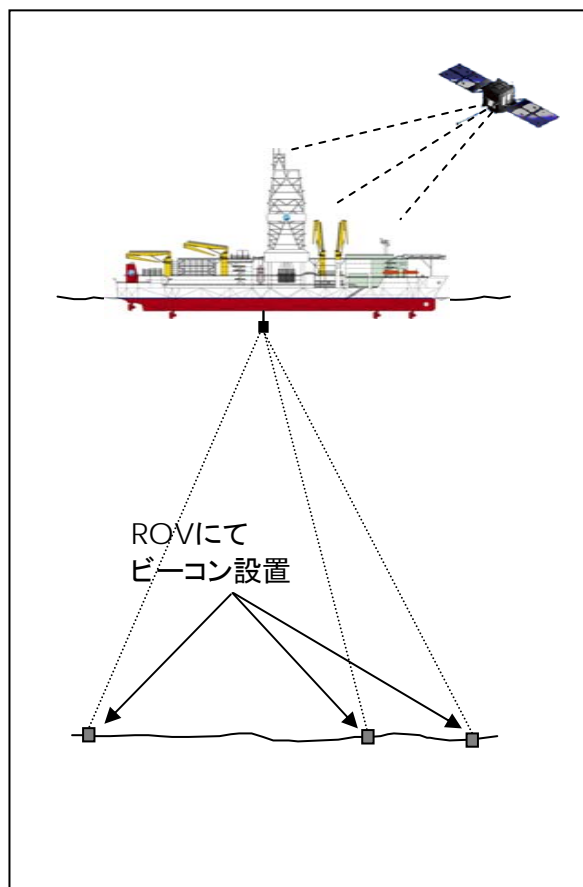


# ＜ライザー掘削試験 概要＞

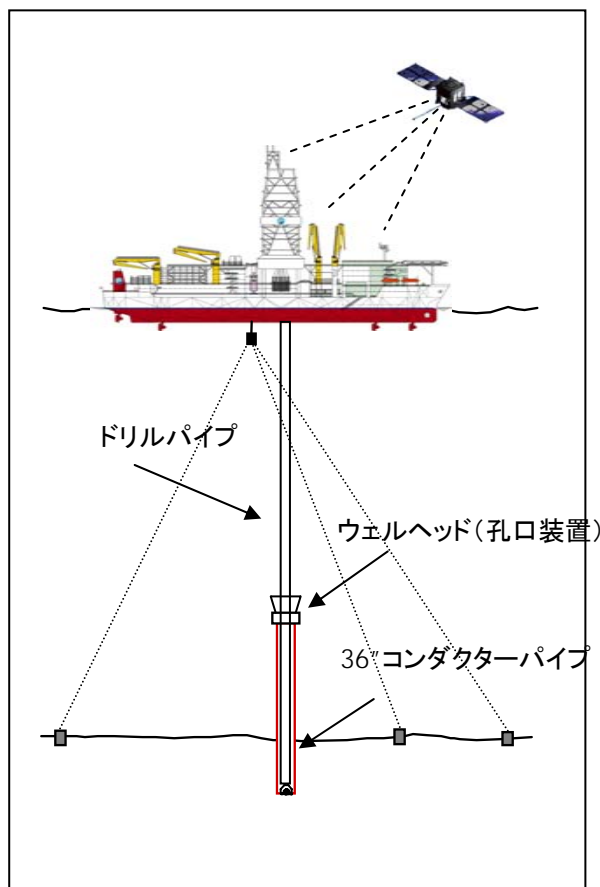
(別添-1)

STEP 1  
DPSにて掘削位置決定



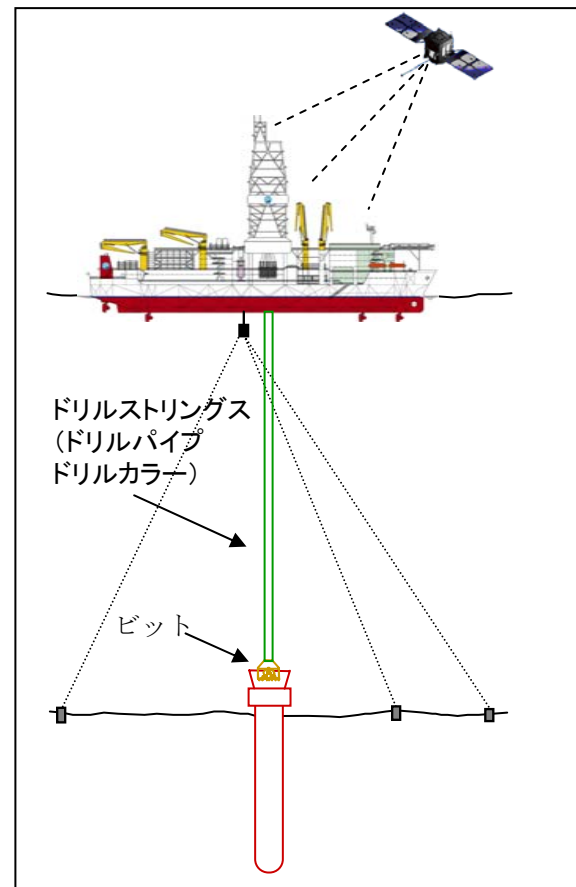
GPS測位及び音響測位により位置を決定しDPSにより定点を保持する

STEP 2  
36インチケーシング設置



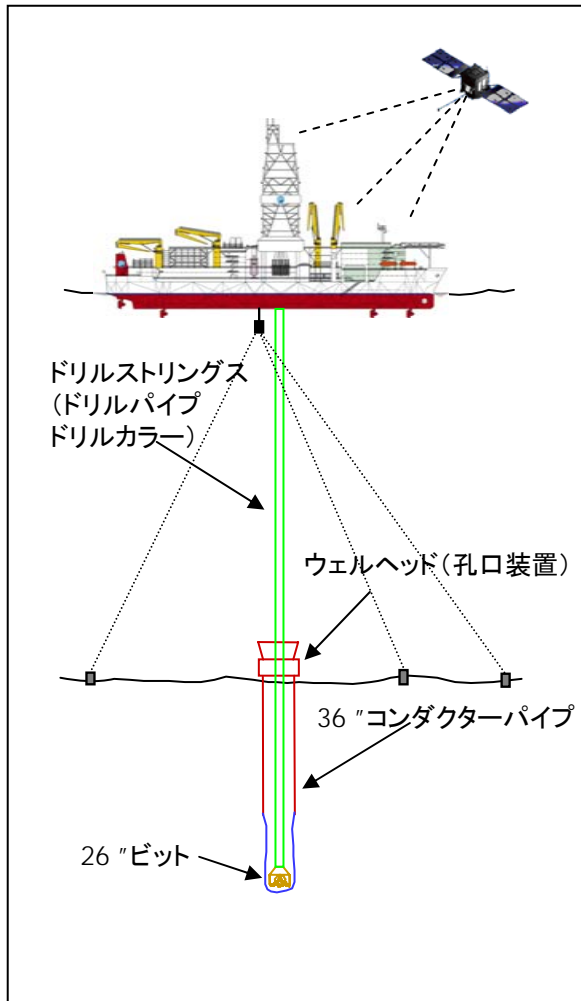
コンダクターパイプを海水圧(水流)及びドリルパイプ重量にて打ち込み設置作業

STEP 3  
26インチビット降下



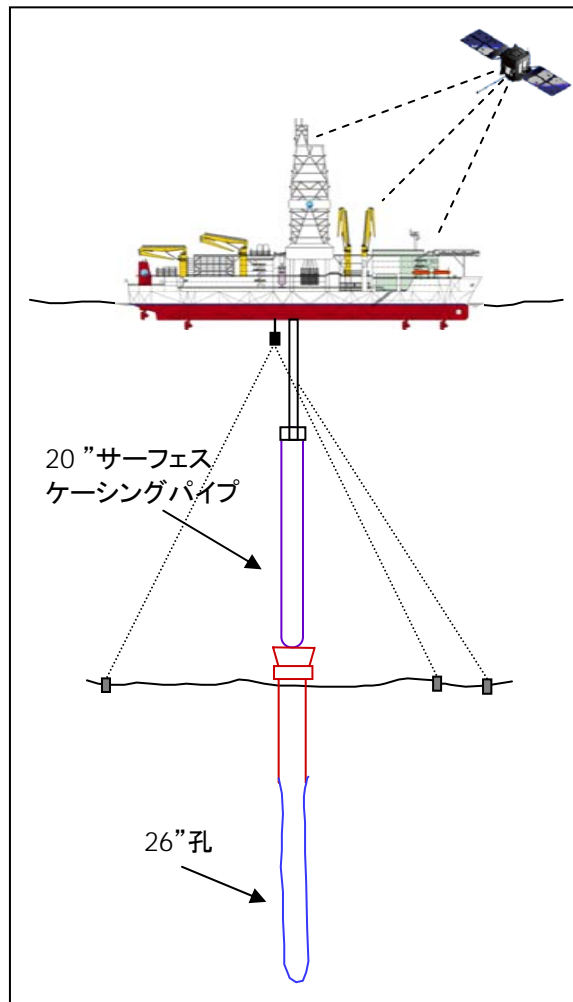
26インチ 孔用ドリルストリングス (掘削編成)を36インチコンダクターパイプ内に降下する

STEP 4  
26インチ 孔掘削



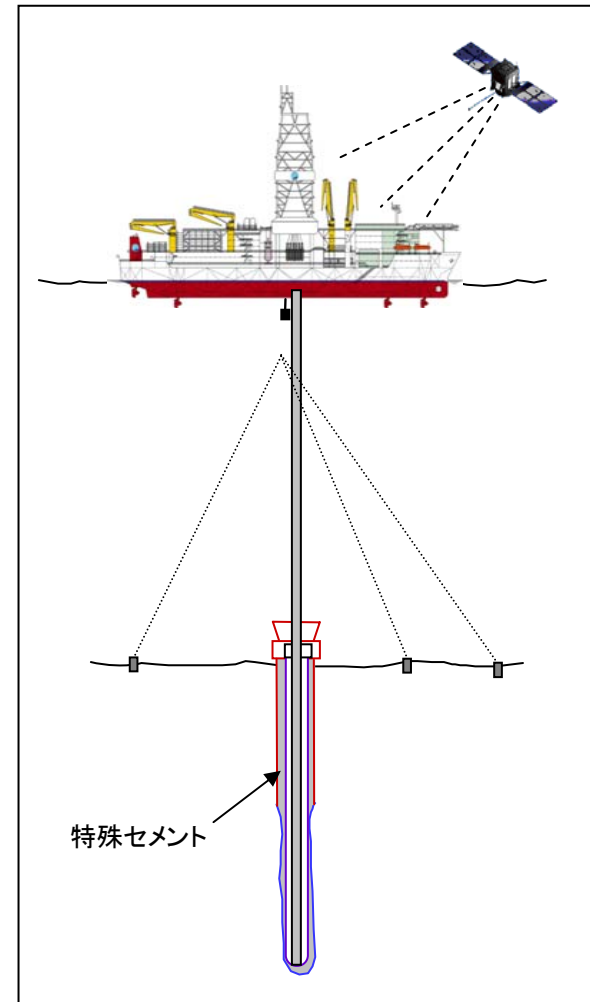
26インチ孔を掘削。予定深度に達したら、20インチサーフェスケーシングパイプ設置を行なう

STEP 5  
20インチケーシング降下



26インチ孔に20インチサーフェスケーシングパイプを降下、設置する

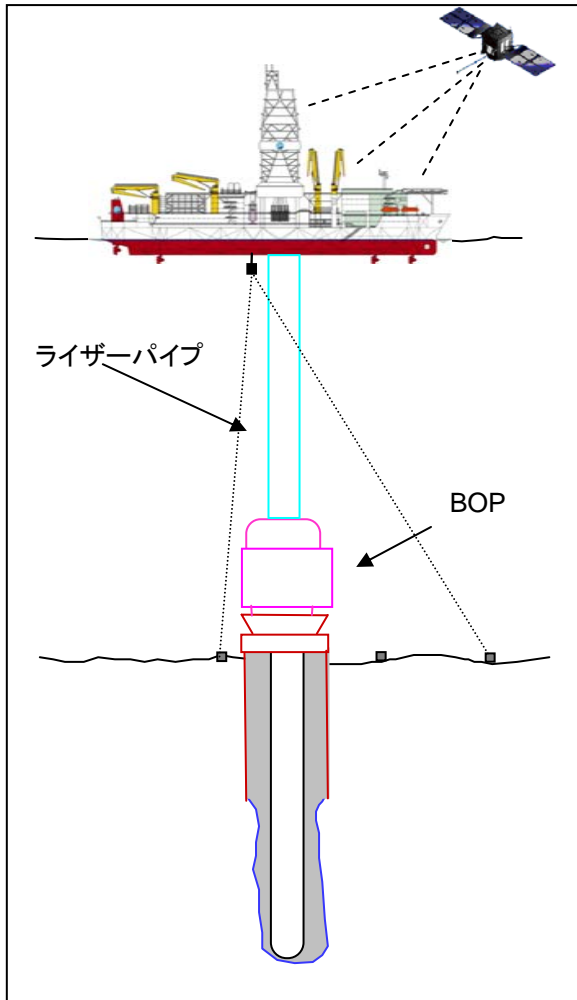
STEP 6  
20インチケーシング設置



20インチサーフェスケーシング降下後、特殊セメントを注入し、固定、設置する

## STEP 7

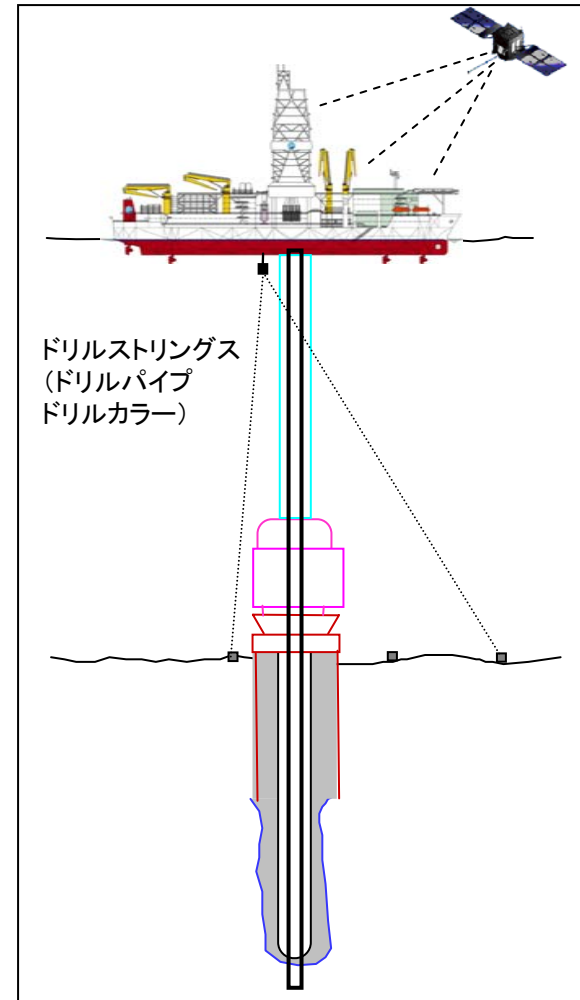
ライザーBOP降下・設置 及び  
緊急離脱システム性能試験



ライザーパイプと共にBOPを降下、  
ウェルヘッドと接続し、設置する。  
BOP中間部を切り離し、緊急離脱  
システムの性能を検証

## STEP 8

ライザー掘削(コアリング、  
物理検層)



ドリルストリングス  
(ドリルパイプ  
ドリルカラー)

ライザー、BOPを再結合し、泥水を  
利用したライザー掘削で試料採取  
試験及び物理検層試験を行う。